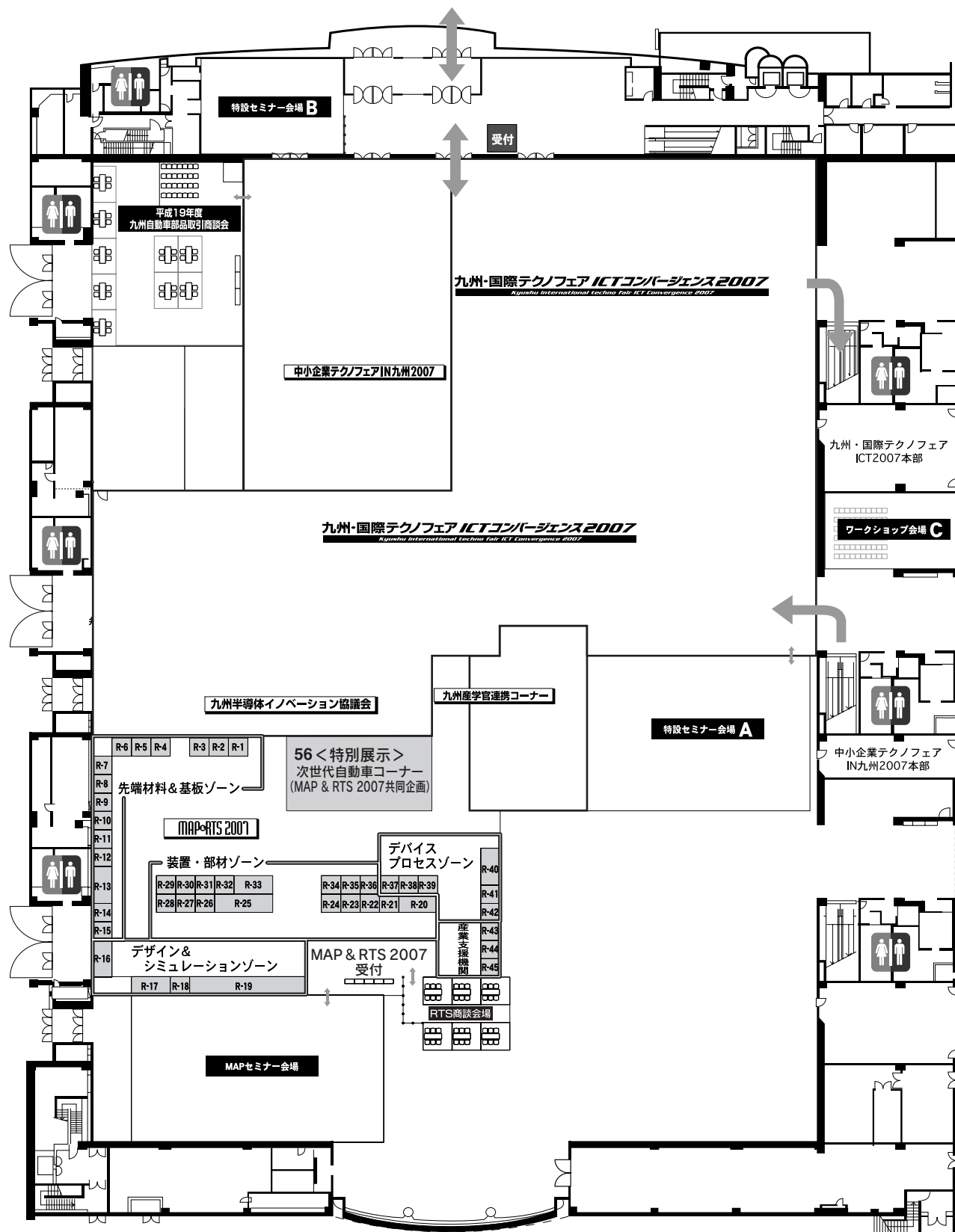


九州国際テクノフェア 会場案内図



●MAP & RTS 2007

zone	小間番号	出展社名	ページ
先端材料&基板	R-1	Plubber Tech	KOREA P.00
	R-2	セラスター(株)	JAPAN P.00
	R-3	住友化学(株)	JAPAN P.00
	R-4	ゼオン物流資材(株)	JAPAN P.00
	R-5	新日鐵化学(株)	JAPAN P.00
	R-6	古河電気工業(株)	JAPAN P.00
	R-7	平井精密工業(株)	JAPAN P.00
	R-8	パナソニックファクトリーソリューションズ(株)	JAPAN P.00
	R-9	(株)ウォルツ	JAPAN P.00
	R-10	イビテック(株)	JAPAN P.00
	R-11	ワボウ電子(株)	JAPAN P.00
	R-12	(株)マルコム	JAPAN P.00
	R-13	千住金属工業(株)	JAPAN P.00
	R-14	(株)プロセス・ラボ・ミクロン	JAPAN P.00
デザイン&シミュレーション	R-15	(株)SiM24	JAPAN P.00
	R-16	丸紅情報システムズ(株)	JAPAN P.00
	R-17	フルーエント・アジアパシフィック(株)	JAPAN P.00
	R-18	(有)ユーテックシステム	JAPAN P.00
	R-19	ナガセ電子機器サービス(株)	JAPAN P.00
装置・部材	R-20	Hanyang University	KOREA P.00
	R-21	Epuller Industrial Project	KOREA P.00
	R-22	タナカ・トレーディング(株)	JAPAN P.00
	R-23	(株)メカトロジャパン	JAPAN P.00

zone	小間番号	出展社名	ページ	
装置・部材	R-24	東レエンジニアリング(株)	JAPAN P.00	
	R-25	(株)日立ハイテクノロジーズ	JAPAN P.00	
	R-26	アキレス(株)	JAPAN P.00	
	R-27	(株)インターテック	JAPAN P.00	
	R-28	福電資材(株)	JAPAN P.00	
	R-29	Frontier Semiconductor	USA P.00	
	R-30	DAE A METAL	KOREA P.00	
	R-31	(株)プロデュース	JAPAN P.00	
	R-32	(株)アドバンテスト九州システムズ	JAPAN P.00	
	R-33	(株)サワーコーポレーション	JAPAN P.00	
	R-34	ヤマハ発動機(株)	JAPAN P.00	
	R-35	櫻井精技(株)	JAPAN P.00	
デバイスプロセス	R-36	(株)ディスコ	JAPAN P.00	
	R-37	ケイ・エス・ティ・ワールド(株)	JAPAN P.00	
	R-38	(株)日立超LSIシステムズ	JAPAN P.00	
	R-39	(株)東芝セミコンダクター社	JAPAN P.00	
	R-40	イーヴィグループジャパン(株)	JAPAN P.00	
	R-41	福菱セミコンエンジニアリング(株)	JAPAN P.00	
	R-42	Sungrim Hitech	KOREA P.00	
	産業支援機関	R-43	北京半導体行業協会	CHINA P.00
		R-44	マレーシア工業開発庁	MALAYSIA P.00
		R-45	東アジア経済交流推進機構	JAPAN P.00

●九州・国際テクノフェア ICTコンバージェンス 2007

56 <特別展示> 次世代自動車コーナー (MAP & RTS 2007 共同企画)



先端材料&基板

Advanced Materials & Substrate

R-1 Plubber Tech (KOREA)

担当: SUN JOO SANG

出展内容

電子部品用熱可塑性粘着シート(TPE)、石材産業サンドプラスト用マスキングテープ、建築及び看板用PCシート

R-2 セラスター(株)

SELASTAR Corp. (JAPAN)

担当: コンポーネントグループマネージャ

小林 茂雄 (Kobayashi, Shigeo)

URL: http://www.selastar.co.jp/

出展内容

百万回コンタクト長寿命テストソケット、高周波テスト治具(テクノカム研究所社製ツイストプローブ、テストソケットおよび高周波テスト治具)

R-3 住友化学(株)

Sumitomo Chemical Co., Ltd. (JAPAN)

担当: 情報電子化学品研究所

岡本 敏 (Okamoto, Satoshi)

URL: http://www.sumitomo-chem.co.jp/

出展内容

液晶ポリマーの等方性加工方法とそれによるシート、フィルム、ブリプレグ等

R-4 ゼオン物流資材(株)

ZEON LOGISTICAL MATERIALS CO.,LTD. (JAPAN)

担当: 販売部

竹内 雅一 (Takeuchi, Masakazu)

URL: http://www.zeon-stec.co.jp/

出展内容

環境配慮型リターナブル・コンテナ(STEC)、梱包副資材の削減等、環境にやさしい物流機器(通い箱)。お客様のニーズにマッチした、オーダーメイド製作品。最適な梱包形態をご提供いたします。物流費のコストダウンにも役立ちます。詳細はHPをご覧ください。

R-5 新日鐵化学(株)

Nippon Steel Chemical Co.,Ltd. (JAPAN)

担当: 機能樹脂事業部

青山 健 (Aoyama, Takeshi)

URL: http://www.nsccl.co.jp/

出展内容

新日鐵化学は、半導体接着材料「エスアレックス(R)」を中心に、お客様のご期待にお応えするための特徴的な技術、及び製品を開発しています。当社ブースでは、当社独自技術を用いた材料及びそのアプリケーションを展示し、付加価値が求められる電子機器分野において、高機能化を可能にするソリューションをご提案します。展示物: 半導体接着材料(フィルム/ペースト)、感光性材料 他

R-6 古河電気工業(株)

THE FURUKAWA ELECTRIC CO.,LTD. (JAPAN)

担当: 環境・エネルギー研究所

天野 俊昭 (Amano, Toshiaki)

URL: http://www.furukawa.co.jp/

出展内容

リアルチップサイズ半導体パッケージ「古河 WL-CSP」、ウェハと樹脂突起電極を持つテープ基板とを貼り合わせるにより、高信頼性、低コスト、短納期を実現します。

R-7 平井精密工業(株)

HIRAI SEIMITSU KOGYO CORPORATION (JAPAN)

担当: 九州営業所

西村 元気 (Nishimura, Genki)

URL: http://www.hirai.co.jp/

出展内容

エッチングの量産工場として1989年に開設した金属の総合加工メーカーです。特に試作レベルでの各種の複合加工が必要な部品作成を短納期ででき、板厚は0.005から3.0mmまで実績があります。また、ヒートシンク、リードフレームの製造に関して高い技術を持っています。

R-8 パナソニック ファクトリーソリューションズ(株)

Panasonic Factory Solutions Co.,Ltd. (JAPAN)

担当: 精密プロセス事業推進グループ

有田 潔 (Arita, Kiyoshi)

URL: http://panasonic.co.jp/pfsc/

出展内容

「プラズマによる薄型ウエハ加工技術」/パナソニックファクトリーソリューションズ(株)が開発中のプラズマダイシング装置の特長や性能について発表いたします。また、同装置でダイシングした実サンプルも展示いたします。

R-9 (株)ウォルツ

WALTS CO.,LTD. (JAPAN)

担当: 取締役

東 俊光 (Higashi, Toshimitsu)

出展内容

次世代実装技術開発用に特化したTEG(Test Elements Group)製品のラインアップを各種展示。福岡大学・友景教授を中心にしたSIPOS委員会でエンベデッド方式SIP開発用途に開発されたTEGや次世代ハイエンド向けファインピッチTEG製品と評価用キット等を紹介する。

R-10 イビテック(株)

BITECH Co.,Ltd. (JAPAN)

担当: 技術グループ

立石 圭太 (Tateishi, Keita)

URL: http://www.ibitech.co.jp/

出展内容

イビテックの得意とする製品のサンプル展示 小型PKG基板数点

R-11 ワボウ電子(株)

Wabo Electoronics Co.,Ltd. (JAPAN)

担当: 博多サテライトオフィス

込山 正義 (Komiya, Masayoshi)

URL: http://www.wabo.co.jp/

出展内容

プリント基板の設計から試作実装・量産までの一貫受託型EMSメーカー: 回路設計・アートワーク設計(プリント基板、サブストレート)、生基板・部品調達、実装(表面実装、フリップチップボンディング、ワイヤーボンディング)、BGAリワーク、リボール、筐体組立検査

R-12 (株)マルコム

MALCOM CO., LTD. (JAPAN)

担当: 営業部

川崎 直之 (Kawasaki, Naoyuki)

URL: http://www.malcom.co.jp/ja/index.html

出展内容

鉛フリーはんだ対応ペースト混練機は温度モニター機能を搭載し、高速かつ安全な混練りを実現します。リフロシミュレーター・ビデオ観察システムはリフロー炉の様々な温度条件を再現しながら多方面から炉内を観察できる実験装置です。

R-13 千住金属工業(株)

Senju Metal Industry Co.,Ltd. (JAPAN)

担当: 福岡営業所

大竹 基之 (Otake, Motoyuki)

URL: http://www.senju-m.co.jp/j/index.htm

出展内容

半導体PKG用鉛フリーはんだ材料、POP実装用はんだ材料 ECOSOLDER PASTE インナーパンブ用はんだ材料 ECO-SOLDER PASTE、パンブ用マイクロソルダーボール

R-14 (株)プロセス・ラボ・ミクロン

PROCESS LAB. MICRON Co.,Ltd. (JAPAN)

担当: 事業開発本部長

千葉 秀貴 (Chiba, Hideki)

URL: http://www.lab-micron.co.jp/

出展内容

FC-BGA/FC-CSP用C4パンブ形成用超高密度メタルマスク、ウェハーパンブ形成用超高密度メタルマスク、および、これらのリフロー工程に利用しうる粘着式キャリアボード、吸着ボックス、挿入・引き剥がし用ツール。150umピッチ、10万~100万パンブレベルの超高密度パンブ形成での量産に採用されています。

デザイン&シミュレーション

Design & Simulation

R-15 (株)SiM24

SiM24 Co.,Ltd. (JAPAN)

担当: 代表取締役社長

大木 滋 (Ohki, Shigeru)

出展内容

1)半導体パッケージ及び電子機器一般に関する受託シミュレーションサービス ①応力解析全般、②熱流体解析全般、③振動解析
2)各種シミュレーションに関するソリューション提供 ①シミュレーション技術の立ち上げ支援、②Total Thermal Engineeringの推進と各種熱解析ツールの提供
3)技術CGコンテンツの作成

R-16 丸紅情報システムズ(株)

Marubeni Information Systems Co.,Ltd. (JAPAN)

担当: 半導体システム事業部 MEMSソリューション部 営業課

橋本 健太 (Hashimoto, Kenta)

URL: http://www.mjsystem.com/

出展内容

MEMSナノテクソリューション、Coventor社半導体向け3次元CADソフトウェア"SEMulator3D"、MEMS設計・解析ツール"CoventorWare"のご紹介の他、MEMS試作サービス、ナノインプリント装置もあわせてご紹介

R-17 フルーエント・アジアパシフィック(株)

Fluent Asia Pacific Co.,Ltd. (JAPAN)

担当: エレクトロニクス・ソリューション事業部

小川 和広 (Ogawa, Kazuhiro)

URL: http://www.fluent.co.jp/

出展内容

■Icepak 電子機器熱流体解析ツール
電子機器の設計者が熱設計に直接利用できるソフトウェアです。ICパッケージ、プリント配線板から筐体、システムレベルまで、エレクトロニクス機器の熱流体解析を容易に実施、心臓部の熱流体解析エンジンとして、世界トップシェアのFLUENTを搭載、電気系CADデータを利用したプリント配線板熱解析モデルの自動構築機能も搭載しています。モデル作成には、機械系3次元CADデータも利用可能です。
■Icemax BGA ICパッケージ寄生パラメータ高速抽出ツール
MCMやPOP等、複雑な先端ICパッケージの解析に対応した、寄生成分抽出ツールです。簡単な操作でICパッケージ設計者がパッケージ全体のRLCパラメータを短時間で入手できます。
■Qfin ヒートシンク・電子機器解析・最適化ツール
ヒートシンクを中心としたエレクトロニクス機器向けの熱解析ツールです。流体部の計算に、ネットワーク法を採用し、非常に高速です。

R-18 (有)ユーテックシステム

U-Tec-System corporation (JAPAN)

担当: 代表取締役

漆島 路高 (Urushima, Michitaka)

URL: http://www16.ocn.ne.jp/~utec/utec2005_001.htm

出展内容

1. UTEC Systemの紹介及び当社のアウトソーシングビジネスの紹介
PSi社IC、南通富士通、CEI(タイ)などの紹介とサンプル展示
2. 多ピン、狭ピッチPackage製品の紹介
Flip Chip T-BGAの紹介 開発サンプル展示あり。
25umPAD Pitch以下の新Packageの提案
3. Image Sensor 向け Flip Chip 構造Packageの紹介
試作サンプル展示

R-19 ナガセ電子機器サービス(株)

Nagase Electronic Equipment Service Co.,Ltd. (JAPAN)

担当: ネットワークソリューションズグループ

香山 雅之 (Kayama, Masayuki)

URL: http://www.nes-nagase.co.jp/

出展内容

「3次元(空間)・4次元(時間)-バーチャルモックアップによる製造シミュレーションシステム-」のご紹介。本システムは、半導体パッケージ製造プロセスにおける"可視化" "協働化" "同期化"を実現する多様な機能を持ち、遠隔地でPC画面及び異なるデータを共有しながら、設計とプロセス・設計と解析との共同作業を実現し、このシステムの3次元可視化技術を用いてバーチャル(デジタル)モックアップを自動生成します。

R-19 オプティマル・ジャパン(株)

Optimal Japan K. K. (JAPAN)

担当: 代表取締役社長

原田 裕幸 (Harada, Hiroyuki)

出展内容

Optimal社は、有限要素法をベースとした、プリント基板/パッケージに特化したシグナル・パワー・サーマルインテグリティ解析ツールをご提案しています。IC-Package-PCBの協調設計を基軸とし、連成解析機能、各社ダイレクトCADインターフェイス、さらには最新の基板技術に対応したモデルにより、幅広い解析ニーズにお応えしております。

装置・部材

Equipment & Parts

R-20 Hanyang University (KOREA)

担当: Young Do Kim

URL: http://www.hanyang.ac.kr/english/

出展内容

1.Low Temperature Densification of Mo Nanoponder Prepared by Mechanochemical process
2.Densification of W-Cu nanocomposite powder prepared by mechanochemical process

R-21 Epuller Industrial Project (KOREA)

担当: CEO

千 今亨 (Cheon, Kuem-Hyang)

URL: http://www.epuller.co.kr/

出展内容

1.Tools of R/D Semi conductor (Degubber/Programmer Solution)
2.Non Chemical Particle cleaner for Semi conductor Wafer



装置・部材
Equipment & Parts

R-22 タナカ・トレーディング(株)
TANAKA CORPORATION (JAPAN)

担 当: 営業マネージャー
黒田 敏之 (Kuroda, Toshiyuki)

U R L: <http://www.3915.jp/>

出展内容
ウェハ検査顕微鏡(レンタル品)の実機展示、中古産業機器の在庫ラインナップの紹介。

R-23 (株)メカトロジャパン
Mechatro Japan Co.,Ltd. (JAPAN)

担 当: 経営企画室
矢野 雄一郎 (Yano, Yuichiro)

U R L: <http://mechatrojapan.com/index.html>

出展内容
メカトロジャパンでは、これまで半導体後工程、実装など各種専用機自動機を開発製造しております。

R-24 東レエンジニアリング(株)
Toray Engineering Co.,Ltd. (JAPAN)

担 当: 瀬田工場
安井 弘和 (Yasui, Hirokazu)

U R L: <http://www.toray-eng.co.jp/>

出展内容
MD3000/MD3500は部品内蔵基板(エンベデッド)用フリップチップボンダーです。大型基板(600×600mm)にWLP、ペアチップを高速、高精度(±5μm)に搭載します。フェイスアップ実装、フェイスダウン実装に対応しており幅広い工法をご選択頂けます。

R-25 (株)日立ハイテクノロジーズ
Hitachi High-Technologies Corporation. (JAPAN)

担 当: 産業システム課
佐藤 誠 (Sato, Makoto)

U R L: <http://www.hitachi-hitec.com/>

出展内容
実装関連設備(プラズマ洗浄装置、テーピング装置)

R-26 アキレス(株)
Achilles Corporation (JAPAN)

担 当: 九州営業所
佐野 博 (Sano, Hiroshi)

U R L: <http://www.achilles.jp/>

出展内容
アキレスは、独自のインジェクション成形技術、静電気対策技術(特殊導電材料ST-Poly、フィルム加工技術、ランタン加工技術をベースに、新しいウェハーパッケージシステムを開発しました。このシステムは薄く割れやすくなったシリコンウェハー、パンプウェハー、化合物ウェハー等多様なウェハーに対応できます。熱対策、電磁波対策用機能性シート(アキレスサーミオン)も紹介いたします。

R-27 (株)インターテック
INTERTEC CORP. (JAPAN)

担 当: 営業部
加藤 修 (Kato, Osamu)

U R L: <http://www.itcj.com/>

出展内容
中古半導体製造装置のご案内 当社では後工程装置を一堂に集めたショールーム「Used Hub Tokyo」に約2,000㎡の広さで300台以上の装置・部品を展示・販売しております。

R-28 福電資材(株)
Fukuden Shizai Co., Ltd. (JAPAN)

担 当: 海外グループ担当
岩田 邦裕 (Iwata, Kunihiro)

U R L: <http://www.fukuden-net.co.jp/>

出展内容
東芝半導体をはじめとした外国系半導体、電子部品、電子材料等の取り扱い。中国東莞地域での基板ASSY事業(EMSサービス)、及び同地区でのロジスティクス倉庫(エパーゲイン社との提携)のご紹介。

R-29 Frontier Semiconductor (U.S.A.)

担 当: V.P.of strategic Business Development
Mark Choi

U R L: <http://www.frontiersemi.com/>

出展内容
NESPA(=Newt Electric Sag Protector Assembly)は瞬間停電補償装置で、2秒以内の電源の瞬断に対応できる装置。SEMIF47規格に対応し、韓国サムソン社が推進している“Power Vaccine”仕様に合致する為に必須の装置です。

R-30 DAE A METAL (KOREA)

担 当: Chung Chun Sub

出展内容
1990年に創立以来、レーザー加工、NCT精密加工、部品組立専門企業として業界屈指の地位を築いて参りました。「最低の価格・最高の品質・最速納期の遵守」をモットーに、原材料のレーザー加工、NCT精密加工、切断、プレス加工、溶接、メッキ、組立、仕上げ等、完成品までの行程をワンストップサービスで行っており、製品の優秀性を認められ、SUNSTARを始め100社を超える需要家との取引を行っています。またここ数年の景気沈滞にもかかわらず、前年度対比20～30%の売上げ増を実現しています。更に政府が主管する各種課題に積極的に参加し、自社ブランドの新製品開発を推進しています。各種特許、ISO9001/14001の認証を取得し、2005年には仁川広域市より有望中小企業に選定され、また新技術開発によるベンチャー企業の指定も受けています。

R-31 (株)プロデュース
Produce Co.,Ltd. (JAPAN)

担 当: 企画開発本部
府川 一 (Fukawa, Hajime)

U R L: <http://www.k-produce.co.jp/index.html>

出展内容
RTSシリーズ:
ロール to ロール方式印刷システムです。円筒型サクシオンテーブルを採用し理想的な版離れにより、高精度・高歩留の印刷を実現しました。
NVDシリーズ:
特殊ノズル・微小流量制御により画期的なスプレー塗布システムです。膜厚ワイドレンジ(10nm～100μm)を実現しました。粒径の大きな固形物が混入しているカーボン・ファイラーでも目詰まりを解消しました。吐着効率～90%を実現しました。

R-32 (株)アドバンテスト九州システムズ
Advantest Kyushu Systems Co.,Ltd. (JAPAN)

担 当: 管理部
園田 明弘 (Sonoda, Akihiro)

出展内容
半導体試験装置紹介パネル、会社情報説明パネル

R-33 (株)サワーコーポレーション
SAWA CORPORATION (JAPAN)

担 当: グローバルセールス部
八木 研 (Yagi, Ken)

U R L: <http://www.sawa-corp.co.jp/jpn/index.htm>

出展内容
半導体装置製造工場で使用されるパンプ印刷用メタルマスク及び電子部品並びにプリント基板装置工場で使用するメッシュスクリーンマスク洗浄に有効。洗浄不良による品質及び作業環境の改善、リワークの低減、人件費などのコスト削減等印刷シーンにおける諸問題の解決手段に効果的。

R-34 ヤマハ発動機(株)
Yamaha Motor Co., Ltd. (JAPAN)

担 当: IMカンパニー
桜井 博 (Sakurai, Hiroshi)

U R L: <http://www.yamaha-motor.co.jp/>

出展内容
・ペアチップ、SMD部品混載マウンター、i-Cube II、YG100
・フルビジョン ロジック IC ハンドラー V4
・産業用ロボット: 単軸ロボット直交ロボット、スカラーロボット

R-35 櫻井精技(株)
SAKURAI SEIGI Co.,Ltd. (JAPAN)

担 当: 設計グループ
田口 智弘 (Taguchi, Toshihiro)

U R L: <http://www.sakuraiseigi.co.jp/>

出展内容
TAB/COF外観検査装置 [CH3100] をパネル展示。
外観異常(ボンディングパッド、ソルダーレジスト、ホール部等)を高速CCDラインセンサーカメラにより自動検査することが可能なリアル・ツアー・リールハンドラです。

R-36 (株)ディスコ
DISCO Corporation (JAPAN)

担 当: NWプロジェクト
森 俊 (Mori, Takashi)

U R L: <http://www.discousa.com/jp/index.html>

出展内容
「Au、Cu、ハンダ等 金属延性材料と樹脂」の複合材料を一括に平坦化・平滑化。
(加工事例)
1) LCDドライバのAuパンプ平坦化 2) 切削平坦化でウェーハ配線形成 3) 樹脂からのメタルポスト頭出し

デバイスプロセス
Semiconductor Device Process

R-37 ケイ・エス・ティ・ワールド(株)
KST World Corp. (JAPAN)

担 当: 営業部
中村 崇 (Nakamura, Takashi)

U R L: <http://www.kstworld.co.jp/>

出展内容
光導波路、MEMS向けに開発した超厚膜(15um)の超酸化膜付きウェーハや、Box層が6um以上の厚みを持つSOIウェーハ、並びに各種成膜加工サービスをご紹介します。

R-38 (株)日立超LSIシステムズ
Hitachi ULSI Systems Co.,Ltd. (JAPAN)

担 当: 営業部営業技術グループ
国兼 好美 (Kunikane, Yoshimi)

U R L: <http://www.hitachi-ul.co.jp/index-j.html>

出展内容
JISSO Solution
半導体実装技術開発をサポートする評価チップ(JTEG)と評価用基板(JKIT)を紹介します。さらにそれらを用いたJISSO Solutionを紹介します。

R-39 (株)東芝 セミコンダクター社
Toshiba Corporation Semiconductor Company (JAPAN)

担 当: システムLSI第2事業部 北九州開発推進室
対馬 敏樹 (Tsushima, Toshiki)

U R L: <http://www.semicon.toshiba.co.jp/>

出展内容
現在、北九州工場にて生産している半導体製品(アナログ製品・光製品等)を中心に、技術及び製品に関する内容をパネルにて紹介すると共に、テクニカル・データ等の資料や、冊子(分野別製品情報)にて、半導体製品の情報を提供します。

R-40 イーヴィグループジャパン(株)
EV Group Japan K.K. (JAPAN)

担 当: テクノロジー本部
ウイクラマナヤカ スニル (Sunil, Wickramanayaka)

U R L: <http://www.evgroup.com/japanese/index.asp>

出展内容
半導体装置業界でのキープレイヤーであるEVGは、300mmまでのウェーハサイズに対応した全自動ウェーハ貼り合せ装置GEMINIのご紹介を致します。位置合わせから貼り合せを一台で行うことができ、各種貼り合せ方法をカバーしています。3次元実装やパッキングプロセスにも対応しています。

R-41 福菱セミコンエンジニアリング(株)
Fukuryo Semiconductor Engineering Corporation (JAPAN)

担 当: 副センター長
杉浦 健 (Sugiura, Ken)

U R L: <http://www.fsec.co.jp/index.html>

出展内容
TOFSIMSを用いた有機解析

R-42 Sungrim Hitech (KOREA)

担 当: CHOI IN HAK
U R L: <http://www.srht.co.kr>

出展内容
中継器HPA、各種モジュール、基地局装備、半導体部品加工

産業支援機関など
Organization etc.

R-43 北京半導体行業協会

Beijing Semiconductor Industry Association (CHINA)
担 当: 副理事長
王 志華 (Zhihua Wang)

U R L: http://www.bjic.org.cn/english/e_index.html

出展内容
清華微電子学研究所、北方微電子基地、中日電子産業扶持中心、北京集成電路設計園、北京洪涛偉業科技有限公司の共同出展

R-44 マレーシア工業開発庁

Malaysian Industrial Development Authority (MALAYSIA)
担 当: 投資促進担当官
田中 百合子 (Tanaka, Yuriko)

U R L: <http://www.midajapan.or.jp/>

出展内容
マレーシアの一般情報や投資ガイド、マレーシア産業などについてご紹介。

R-45 東アジア経済交流推進機構

The Organization for the East Asia Economic Development (OEAED) (JAPAN)
担 当: 吉田 智子 (Yoshida, Tomoko)

U R L: <http://www.pysih.net/jp/>

出展内容
環黄海圏の日中韓10都市の市長と経済界の代表が一体となり設立した組織です。ビジネスチャンスの拡大と相互交流の活発化を通じて、“環黄海経済圏”の形成をめざしています。機構の紹介パンフレット、会員都市の投資環境・企業誘致情報等のパンフレット等を展示・配布します。